

2024 九峰山论坛暨中国国际化合物半导体产业博览会 (JFSC&CSE 2024)

会议通知

半导体芯片技术是现代科技发展的核心驱动力之一，随着硅材料的物理极限日益显现，以化合物半导体为代表的新材料快速崛起，对全球半导体产业格局的重塑具有重大影响。加快发展化合物半导体产业，对于提升我国半导体产业基础和建立未来战略优势至关重要。为搭建高端产业技术交流平台，吸引全球优质资源，推动我国化合物半导体产业的发展，首届中国光谷九峰山论坛暨化合物半导体产业发展大会已于 2023 年 4 月在东湖高新区成功举办，吸引来自国内外的高校、科研院所、企业和投资机构等 1200 余名代表参会。

本次会议由第三代半导体产业技术创新战略联盟和九峰山实验室共同主办，将集会、展于一体，旨在进一步深化九峰山科技园区“一核三区，双轴交汇”的战略布局，将其打造为全球化合物半导体行业创新体系的战略支点，推动中国光谷与全球化合物半导体创新网络深度链接，吸引全球技术及产业资源聚集，扩大武汉在化合物半导体领域的国际影响力和产业引领作用。

主办单位：第三代半导体产业技术创新战略联盟、九峰山实验室

时间：2024 年 4 月 8-11 日

地点：中国·湖北·武汉·中国光谷科技会展中心

活动名称	门票类别	票价			权益（“√”为包含权益）					
		3月1日前优惠价	3月20日前优惠价	原价	参加论坛	参观展会	展会同期活动	会议用餐	茶歇	资料
2024 九峰山论坛	论坛门票	2000	2200	2500	√	√	√	√	√	√
中国国际化合物半导体产业博览会	展会门票	免费			无	√	√	无	无	无

报名注册及缴费方式：可通过线上报名缴费、银行汇款、现场注册缴费三种方式。（*备注：参会代表须提前完成线上注册。选择银行汇款及现场缴费方式支付时，请务必备注参会人员的单位+姓名，以便查询及开具发票。开具发票须将报名信息、转账凭证、开票信息发送至邮箱：lilyli@china-led.net；线上报名缴费可直接线上申请发票。）

(一) 线上注册报名缴费



2024九峰山论坛暨中国国际化合物半导体产业博览会官网&报名通道

(二) 银行汇款

所有参会&观展代表，均须先通过扫描官方报名通道二维码，完成注册报名，再通过银行汇款支付。

名称：北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司

账号：336 356 029 261

开户行：中国银行北京科技会展中心支行

(三) 现场缴费

会议期间到报到处现场通过刷卡、支付宝&微信等方式完成支付。

会议网址： <http://www.jfsc.org.cn/>

联系人： 芦老师，010-82380580，lul@casmita.com

2024 九峰山论坛暨中国国际化合物半导体产业博览会

组委会

ORGANIZING COMMITTEE

组委会

二〇二四年三月

附：会议信息

会议时间：2024年4月8-11日

会议地点：湖北·武汉·中国光谷科技会展中心

主办单位：第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA）、湖北九峰山实验室

大会亮点：

最有价值的产业交流平台：800+企业代表，300+参展企业，300+行业领袖，120+主题报告分享，洞悉全球化合物半导体发展态势，交流研讨最新技术、产业话题，展示产品、服务与解决方案，是目前化合物半导体领域最高端、规模最大的交流合作平台。

最具权威的政策解读平台：主论坛、分论坛特邀院士大咖等嘉宾，权威解读国家产业政策走向、科技计划布局、重大载体平台建设，一站式头脑风暴共谋产业发展。

最具创新力的资源聚合平台：汇聚化合物半导体产业相关科研院所、技术专家、企业高管、投资机构、行业媒体等资源，聚焦创新创业与投资孵化，持续打造化合物半导体的创新高地。

最国际化的宣传推广平台：1场大会、8场平行论坛、10+专题研讨、5000+专业观众、10000米主题展览，线上+线下覆盖化合物半导体全产业链，同期交流晚宴、商务考察务实求效，媒体矩阵多维度呈现。

会议总体日程（拟）：

日期	时间	内容	
4月8日 星期一	14:00-20:00	注册报到	
4月9日 星期二	09:00-09:20	巡馆	中国 国际 化合 物半 导体 产业 博 览 会
	09:30-10:30	开幕式	
	10:30-17:30	主旨演讲	
	19:00-21:00	欢迎晚宴	
4月10日 星期三	09:00-17:30	平行论坛 1：化合物半导体关键材料 平行论坛 2：化合物半导体核心装备 平行论坛 3：EDA 工具与生态链 平行论坛 4：光电子技术 平行论坛 5：功率电子技术 平行论坛 6：无线电子技术	
4月11日 星期四	09:00-12:00	平行论坛 7：先进半导体检测技术与标准 平行论坛 8：化合物半导体投融资趋势	